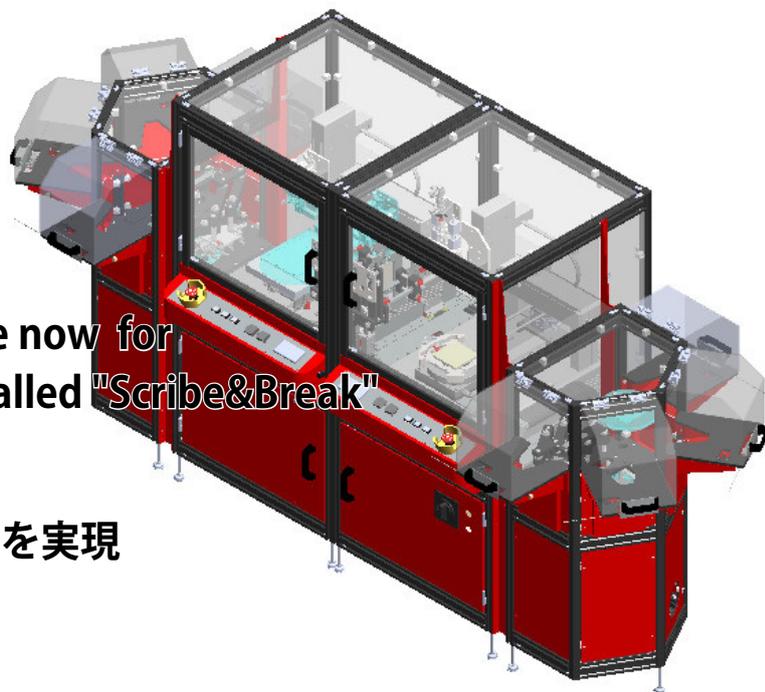


全自動スクライブ&ブレイク装置

MCSB6-200LD

High speed and dry process is possible now for ceramics by adopting a new method called "Scribe&Break"

新工法 "スクライブ&ブレイク" を採用することにより高速度・ドライ加工を実現



Features

- High quality : No thermal effects, debris and chipping on substrate edge after process.
- Advantage : Higher speed/Dry process/No kerf-loss compared to other process method
- Alterability : Easy to process ceramics and other brittle materials by changing scribing tool and settings.
- Low environmental demand : Process without any special environmental requirement, neither assist gas nor shielding for laser.

特徴

- 高品質 : 熱影響・デブリ・チッピングのない基板エッジ
- 高効率 : 高速度・ドライ加工、かつカーフロスのない加工方法
- 利便性 : 簡単な工具交換と荷重変更のみで、さまざまな材料を加工可能
- 設置環境 : アシストガスやレーザ光の遮蔽が不要。またほとんど粉塵発生のない加工

Spec

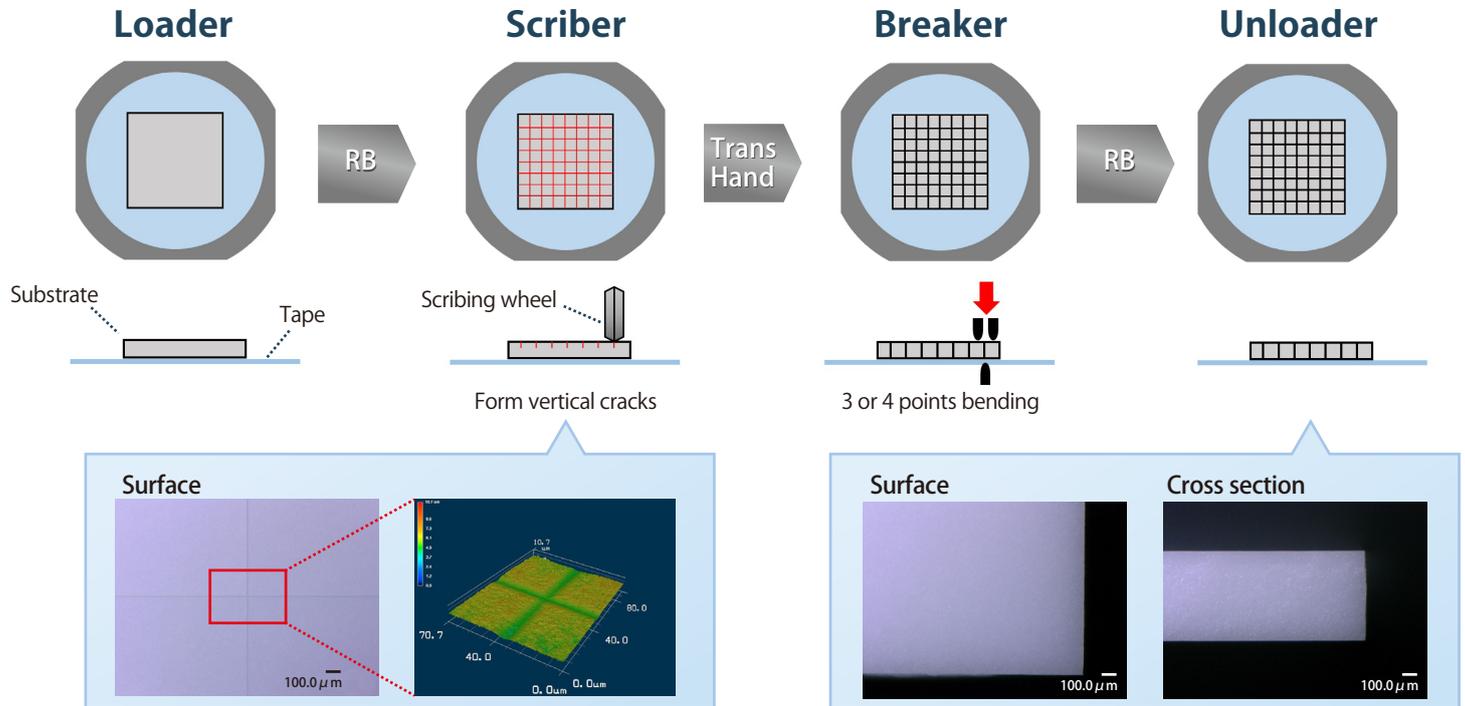
Substrate Thickness 対応基板厚み	~1 mm	Utility ユーティリティ	電源 200VAC 3P 20A CDA 0.5MPa 120LPM
Substrate Size 対応基板サイズ	フレーム未使用時 Max200x200mm 6"丸フレーム使用時 Max100x100mm 6"角フレーム使用時 Max150x150mm	Scribe Speed スクライブ速度	~300 mm/s
Dimensions 装置サイズ	2,810mm(W) x 1,070mm(D) x 1,450mm(H) ※突起物除く	Scribe Accuracy スクライブ精度	±50um (オプション仕様 : ±30um)

Brand-new automatic scribing and breaking equipment with transfer

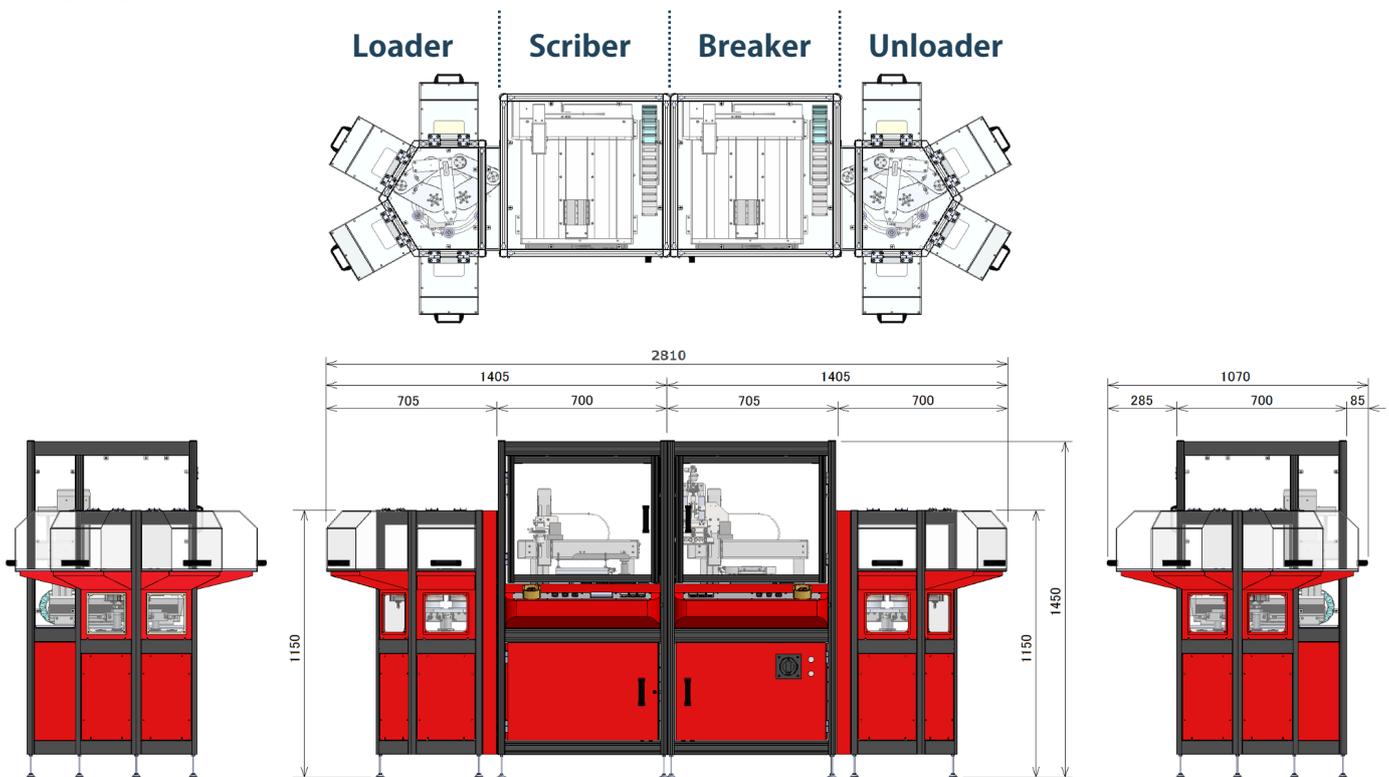
セラミックス基板向け切断装置

全自動スクライブ&ブレイク装置 MCSB6-200LD

Process of "Scribe & Break, S & B"



Equipment outline



※Trademarks and registered trademarks used herein are the property of their respective owners. The specs are subject to change without prior notice.
 ※本カタログに記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。記載された外観・仕様は予告なく変更することがあります。

お気軽にお問い合わせください

TEL : 072-648-5000

FAX : 072-648-5201

URL : www.mitsuboshidiamond.com

三菱ダイヤモンド工業株式会社

〒566-0034 大阪府摂津市香露園 32-12